

2025 年度 決算説明会における主な質疑応答

内容につきましては、ご理解いただきやすいよう部分的に加筆・修正しております。

回答者：代表取締役社長 社長執行役員 加藤 忍、取締役 常務執行役員 横手 幸成

<全般>

Q1： 4 月に社長に就任されたが、前社長の戦略をどの程度踏襲し、何を変える考えか聞かせてほしい。

A1： 私は 1996 年に入社して、今年でちょうど 30 年になる。振り返ると、現場、海外、そして経営を学んだ 30 年であった。最初の 10 年はモータの品質保証に携わり、この現場でものづくりの原点は現場にあること、そして品質は会社の信頼そのものだということを学んだ。次の 10 年は中国現地法人の立ち上げと運営に携わった。ここでは世界で戦うには日本の常識だけでは足りないということを学んだ。同時に、日本のモノづくりの強みも改めて実感した。帰国後の 10 年はモータカンパニー社長として経営を経験した。当社の中期経営計画 2028 は、2024 年度から 5 年間の計画である。私は、この計画の基本方針を継承しつつ、さらに、強く、しなやかにしていきたいと考えている。当社グループの電力機器、回転機、プリント基板の 3 つの事業は、それぞれ異なる市場で戦っており、だからこそ、変化の激しい時代にも柔軟に対応できる、この多様なポートフォリオが当社グループの強みである。私の強みである若さと国際性で、グローバルな視点とスピード感をもって経営に取り組んでいく。

Q2： 2026 年度の業績予想には、中東情勢の影響を織り込んでいるか。織り込んでいる場合、どの程度を見込んでいるか。

A2： 中東情勢の影響について、現段階で具体的な影響額を算出することは難しいため、現時点では織り込んでいない。

中東情勢等、事業環境の変化を踏まえ、今後、公表の必要が生じた場合には適切に開示する。

Q3： 中東情勢についての生産面、調達面での影響は。

A3： 業績予想の算出時点では、事業運営・収支に、影響は織り込んでいない。

現時点においても、生産への影響はないが、塗料類、油脂類、絶縁材、梱包材等については受注制限や値上げ等の情報を取引先から受領しているものもある。

中東情勢の混迷が継続した場合には、生産・販売に影響が出る可能性があるため、引き続き、調達部材の確保と情報収集を進めていく。

Q4： 2025 年度は、期初計画（2025 年 4 月 30 日開示）で営業減益であったが、増益の結果であった。予想を読み違えた理由は。

A4： 2025 年度期初予想から上振れした主な要因として、プリント基板事業の売上が前期比で 90 億円伸び大幅な増益となった。一方で、回転機事業が予想より下がった。この入り繰

りにより結果として増収増益となった。

Q5： 2025年度は、売上・利益ともに期初計画を超過する業績ながら、設備投資が83億円と期初計画の131億円に未達となった理由は。

A5： 設備投資については、3事業ともに当初計画から減少した。電力機器事業は2026トップラランナー変圧器の生産能力増強計画の一部が2026年度に繰り延べとなった。回転機事業は外部環境により投資の一部を見送った。プリント基板事業は第4期生産能力増強投資を進めているが、一部設備の仕様高度化見直しをしたことにより、2026年度に繰り延べしたものもある。結果として、設備投資額が全体で83億円となった。

Q6： 2026年度は増収ながら営業減益の計画だ。前期のようになるのではないかと。減益についてもう少し説明してほしい。

A6： 2026年度業績は、増収減益を予想している。減益要素として、減価償却費や人件費が増加することに加え、プリント基板事業においても材料費率が上昇するとみている。また、電力機器事業もトップラランナー変圧器の計画を慎重に見極めている。プリント基板事業やトップラランナー変圧器の受注状況によっては利益が上がる可能性がある。

Q7： 各セグメントの2026年度の売上、利益の予想は。

A7： 2026年度セグメントごとの売上・利益予想は開示していない。セグメントごとの見通しは、各セグメントの正確な数字の算定が困難な面もあり、現時点では具体的な回答は控える。

Q8： 2025年度の営業利益が111億円と、2028年度の中期経営目標100億円を超えているが計画の見直し予定は。

A8： 現在、中期経営計画の見直しの検討を行っている。中東情勢等、事業環境の変化を踏まえて検討しており、策定した際は公表させていただく。

Q9： 銅や鉄鋼などの原材料価格の変動に対して、製品価格への転嫁の状況は。また、今期の利益計画にどの程度反映しているか。

A9： 当社の主要材料は銅、鉄、油、マグネットである。一部の製品については、材料の市況を売価に反映するフォーミュラ制を導入している。2025年度については、材料高騰に伴う大きな影響は出ていない。2026年度も主要材料についてはフォーミュラの仕組みを継続しているが、具体的な影響額は差し控える。

Q10： 今後の成長ドライバーは、どの事業、どの製品か。

A10： 生成AIの普及により需要が拡大している「パッケージ基板用コア」、電力需要の増加に伴い需要拡大が見込まれる「一般産業向けトップラランナー変圧器」の領域を中期的な成長ドライバーと位置付けている。設備投資にあたっては、外部環境を見極めながら検討していく。

Q11： 将来的に東証での株式上場の可能性は考えているか。

A11： ご承知のとおり、当社は名古屋証券取引所のプレミアム市場に現在上場している。最適な

上場市場については、従来、常々情報収集し研究しているが具体的な計画はない。

<電力機器事業>

Q12: AI データセンター建設ラッシュによる直接的（データセンター向け変圧器等）、間接的（周辺の送配電網の状況）な恩恵は、現在の受注残や引き合い（パイプライン）にどの程度現れてきているか。

A12: 直接的な影響としては、弊社のカテゴリーにおいては一般産業用変圧器が該当するが、弊社では最終的な顧客が、どのような利用目的で変圧器を購入しているか、詳細に把握していないため、AI やデータセンターへの影響については回答できない。

また、間接的な影響としては、一般送配電事業者向けの中・大型変圧器が該当する。主要顧客からの受注により、現時点で 2027 年度納入分まで概ね受注を確保している状況。一般送配電事業者向けの中・大型変圧器が、AI やデータセンター建設によるものなのか、更新需要によるものか、弊社では判断できないが、AI やデータセンター関連の需要増による影響が一定程度生じているものと受け止めている。

なお、具体的な影響については、特定が困難であるため、回答は控える。

<プリント基板事業>

Q13: プリント基板の事業モデルとサプライチェーンでの立ち位置は。具体的な製造品目は CCL（Copper Clad Laminate：銅張積層板）か。ガラスクロスや樹脂を調達し成型するまでか。穴あけ加工もするのか。

A13: プリント基板事業でのサプライチェーンの立ち位置は、AI サーバ向け等の半導体を製造するところから、その下のパッケージ基板メーカーがある。当社子会社の愛工機器製作所は、パッケージ基板メーカーに納入するパッケージ基板用コアを製造している。

具体的な製造品目としてはパッケージ基板の中心部にあるコア材で、材料として CCL を調達している。穴あけ加工も実施している。

Q14: パッケージ基板用コアの顧客はどのような企業か。また、競合他社にはどのような企業があるか。

A14: 顧客情報については、顧客との間で秘密保持契約を結んでおり、回答を差し控える。競合は、顧客であるパッケージ基板メーカーの内製化である。

Q15: パッケージ基板の顧客数は何社くらいか。上位 3 社から 5 社の売上高構成比はどのくらいか。

A15: 主要顧客数は 10 社くらいである。上位 3 社から 5 社の売上構成比は 9 割を超えるとみている。

Q16: パッケージ基板用コアの生産能力は、設備投資完了後にどの程度増えたか。

A16: パッケージ基板用コアの生産能力増強は、旺盛な需要に応えるため、2019 年度以降継続して取り組んでいる。現在、春日井工場を含め累計で約 230 億円の設備投資を実施している。投資前と比較し、生産能力を約 2.2 倍に拡大する計画である。

Q17: パッケージ基板用コアの材料である CCL（Copper Clad Laminate：銅張積層板）等原材

料の調達環境はどうか。また、価格転嫁はできるのか。

A17: CCL の材料として使っているガラスクロスの需給は、業界全体でひっ迫している。一部製品は生産調整しており、客先や調達先と連携して、引き続き調達の確保に努めていきたい。価格転嫁については、客先と調達先連携の中で交渉していく。

Q18: パッケージ基板用コアについて、技術優位性、課題、前期の製品構成の変化の内容、受注状況、2030 年くらいまでの引き合い状況、足元の生産稼働率を教えてください。

A18: 当事業における当社の強みは、正確・緻密な加工技術、数量を供給できる量産設備を保有しており、品質や納期面においても顧客の要求に応える体制を維持していることである。この先の見通しとしては、当面ガラスクロス材料等の需給ひっ迫が続く懸念があるものの、市場規模は長期的には拡大傾向が続くとみている。課題としては、生産能力の増強に加え、製品仕様の高度化への対応や高機能コアの量産に向けた設備投資の継続と認識している。製品構成、受注状況などについては回答を差し控える。

Q19: パッケージ基板用コアは ABF 基板向けが多いのか。

A19: 当社のパッケージ基板用コアは、顧客の後工程(ビルドアップ等)を経て FC-BGA パッケージ基板になり、ABF 基板は同義と捉える。この FC-BGA パッケージ基板は、当社顧客の後工程なり、顧客の工程については回答を差し控える。

以 上

注意事項

業績見通しなど将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。